

ICS 31-030

L 90

备案号: 9883-2002

**SJ**

# 中华人民共和国电子行业标准

SJ/T 3326—2001

---

## 陶瓷—金属封接抗拉强度测试方法

**Test method used in tensile strength of  
ceramic to metal seal**

2002-01-31 发布

2002-05-01 实施

---

中华人民共和国信息产业部 发布

# 前 言

本标准是对 SJ/T 3326—89《陶瓷—金属封接抗拉强度的测试方法》进行的修订。

修改的主要内容：

1) 字叙述的改变，如抗张外力改为抗张应力，浇铸改为浇注。

2) 陶瓷试样表面粗糙度以  $\sqrt{1.6}$  改为  $\sqrt{0.8} \sim \sqrt{1.6}$ 。

3) 陶瓷件材料标准以 GB 5593—85《电子元器件结构陶瓷材料》改为 GB/T 5593—1996《电子元器件结构陶瓷材料》。

4) 陶瓷试样中，增加 A 面平面度的要求。

5) 加载速度以不大于 200 N/s 改为不大于 100 N/s。

本标准从实施之日起，同时代替 SJ/T 3326—89。

本标准由中华人民共和国信息产业部提出。

本标准起草单位：信息产业部电子第十二研究所、中国电子技术标准化研究所（CESI）、江苏陶瓷研究所。

本标准主要起草人：高陇桥、钦征骑、李景勋、曾桂生。